

ISSP2005 商品パネル展示コーナー出展のお願い

日本真空協会では2005年6月8日から10日の3日間、金沢国際ホテルにおいて第8回スパッタリング&プラズマプロセス国際会議(ISSP2005)を開催いたします。スパッタリング&プラズマプロセス技術は今や広範な工業技術分野と密接に関わる重要な技術となっています。この会議はスパッタリング及びプラズマプロセスに関わる各国の企業・大学の研究者・技術者が多数出席する特色のある学会です。今回の会議でも、関連素材・装置・デバイスに関する最先端の技術の発表や、活発な議論・情報交流が期待されます。この会議ではポスターによる研究発表に併設して、各企業の商品パネル展示コーナー*を設置いたします。ちなみに、前回のISSP2003では約300人が参加し、23社のパネル展示が行われました。このコーナーは、関連企業各位の優れた技術・製品・サービスに関する情報を、さまざまな分野の研究者・技術者に提供するための格好の場と思われます。つきましては、ISSP2005商品パネル展示コーナーに是非ご出展いただきますようお願い申し上げます。なお、ISSP2005についての最新情報は<http://issp2005.org>をご覧ください。

商品パネル展示コーナー募集要項

【募集分野】

各種プロセス装置（スパッタ/蒸着/MBE/CVD/エッチングなど）
各種分析計測装置
各種関連部品（スパッタターゲットなど）

【開催場所・期間】

金沢国際ホテル（2005年6月8日から10日まで）

【展示参加料金】

12万円（一単位あたり）

【出展社特典】

展示企業様ご希望により論文集（プロシーディングス）1ページ（A4サイズ）にモノクロ広告を無償で掲載できます。ただし、論文集と同様に写真製版での印刷のため印刷品質はそれほど上質では有りません。

希望によりISSP2005のWebsiteから展示企業様ホームページへのリンクを貼らせて頂きます。

【申込方法・締切】

別紙申し込み用紙に御記入の上、申し込み用紙記載の宛先までEmailでご送付ください。

締切： 2005年4月8日

会議録広告掲載を希望される企業様はA4一頁に印刷した紙原稿、あるいはPDFファイルを、上記期日までに、担当委員（末尾参照）までお送りください。

【展示方式の概要】

展示は別に規定した大きさを一単位として行います。一単位の中では、パネル、机、の二つが展示のために利用できます。複数単位の申し込みも受け付けますが、会場構成などの都合上、後で調整させていただく場合があります。

国際学会という性格上、説明文、その他の文字は、英文に限ります。

展示品の準備・後片付けなどは、原則的に展示者で行ってください。

展示品の説明者を最低一名参加させてください。説明者は、ポスター・講演を含む全てのセッションの聴講が可能です。

説明者として一社から複数名参加していただく場合、二人目、三人目の参加登録料は一人当たり2万円となります。但し、四人目以降の方は通常の会議参加者として登録して下さい。

* ISSPのパネル展示は、招待メーカーによるManufacturer's Presentationとは異なりますのでご注意ください。

展示品は会期終了まで撤去しないで下さい。

【展示の詳細規定】

パネル

パネル面の大きさ(一単位)...幅180 cm×高さ90 cm (A0サイズ2枚分)

展示対象物...カタログ、ポスターなど

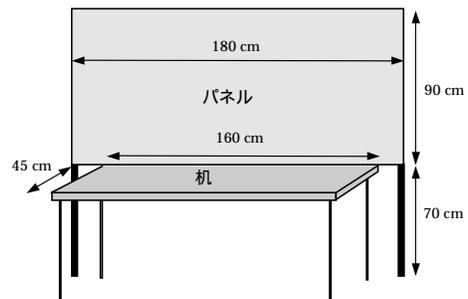
電飾パネルなどの重量物は不可

机

机の大きさ(一単位)...幅160 cm×奥行45 cm×高さ70 cm

展示対象物...総重量10 kg以下であり、上記の机上に展示可能なものに限ります

パソコンのための電源が利用できますが、容量は、100 V、2 Aまでです。希望者は申込書に記入して下さい。これ以外の展示方法をご希望の方は御相談下さい。



【問い合わせ先・申し込み先】

ご不明な点は下記の実行委員会パネル展示担当者までお問い合わせください。

〒183-8508 東京都府中市四谷 5-8-1 アネルバ(株)アネルバテクノキャンパス 小林司

E-mail : kobayashit@mhb.anelva.jp

TEL : 042 - 334 - 0259

FAX : 042 - 360 - 2277

過去の展示会出展社 (順不同)

- ・ BOC Coating Technology
- ・ Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik
- ・ (株)FTS コーポレーション
- ・ NOA SYSTEMS Inc.
- ・ NTT アフティ (株)
- ・ Singulus Technologies AG
- ・ Sputtered Films, Inc.
- ・ (有)VIC インターナショナル
- ・ Von Ardenne Anlagentechnik GmbH
- ・ (株)アイメック
- ・ アステック(株)
- ・ アドバンスト・エナジー・ジャパン(株)
- ・ アネルバ(株)
- ・ (株)アルバック
- ・ (株)エフティーエスココーポレーション
- ・ オックスフォード・インストゥルメンツ(株)
- ・ サイエンステクノロジー(株)
- ・ サエス・ゲッターズ・ジャパン(株)
- ・ サンユー電子(株)
- ・ (株)ジャパンエナジー / (株)日鉱マテリアルズ
- ・ (株)昭和真空
- ・ (株)シンクロン
- ・ (株)ティーディーワイ
- ・ 日真精機(株)
- ・ 日本エムケーエス(株)
- ・ 日本電子(株)
- ・ 日立造船(株)
- ・ 日本ビーコ(株)
- ・ 伯東(株)
- ・ ヒュティンガ・ジャパン(株)
- ・ ペガサスソフトウェア(株)
- ・ (株)マツボー
- ・ 丸文(株)
- ・ 三菱マテリアル(株)
- ・ (株)ユニバーサル・システムズ
- ・ ライボルト(株)
- ・ (株)ランドマークテクノロジー

前回ISSP2003展示会の様子



Exhibit Poster Session